

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2020 年 5 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>5月6日 14:00-15:00</u> 美林证券 Hel Ved Capital_ <u>5月15日 15:30-16:30</u> Kredens Capital <u>5月18日 16:00-17:00</u> 瑞信证券 BFAM EURIZON CAPITAL CS FOUNDER INVESCO CLOUDALPHA CAPITAL PARANTOUX CAPITAL LT PAG MLP CREDIT SUISSE FOUNDE ESPERON CAPITAL ASHMORE WELLINGTON MANAGEMENT FORCHN INTERNATIONAL CREDIT SUISSE OBERWEIS ALLIANZ GLOBAL INVESTOR SYLEBRA CAPITAL LIMITED GREEN COURT CAPITAL

	HORIZON ASSET SEATOWN HOLDINGS SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION KADENSA <u>5月20日 9:00-10:00, 13:00-15:00</u> 天风证券 博时基金 华安基金 华商基金 银华基金 <u>5月25日 9:00-10:00</u> Brilliance Capital China Galaxy Asset Management China Re Cloud Alpha Capital COAMCI CPIC Investment Management (H.K.) GIC Golden Nest Capital Goldstream Capital Green Court Capital Management Greenwoods Haitong International Hel Ved Inventio Capital Lizen Asset Management LMR Partners Manulife Modus Asset Management Orchid Asia Overlook Investments PAG Ping An of China Asset Management Trikon AM UBS O'connor UG Investment Advisers Ward Ferry Yiheng Capital Yulan Capital 昌都市凯丰投资 东亚联丰投资 复胜资产 工银安盛人寿保险 工银瑞信基金
--	---

	广发资管（香港） 海宁拾贝投资 韩国投资 泓德基金 华宝基金 华夏久盈资产管理 汇丰晋信基金 蓝藤资本 美的-盈峰资本 美迪金融集团 摩根士丹利华鑫基金 平安信托 上海混沌投资 兴全基金 银河基金 元大投信 长盛基金 招商基金 正谊资本 中国人寿资产管理 中金公司 中邮创业基金 等
时间	5月6日 14:00-15:00、5月15日 15:30-16:30 5月18日 16:00-17:00、5月20日 9:00-10:00, 13:00-15:00 5月25日 9:00-10:00
地点	华润微电子会议室-在线电话会议
上市公司接待人员姓名	华润微电子董事、助理总经理兼财务总监 彭 庆 华润微电子董事会秘书 吴国屹
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司的自有产品是否有外部代工？ 答：目前公司的绝大部分产品都是自己工厂生产，小部分安排外部代工。公司秉着效率原则、合理利用外部资源进行生产。 问题二：公司目前自有产品占总营收的45%左右，请问公司如何提高该业务的营收占比？ 答：公司一方面加大研发投入，发展公司自有产品业务；另一方面，围绕功率半导体和智能传感器进行外延式并购。 问题三：国内IGBT的市场规模有多少？中国占全球市场规模大约多少？进口替代前景如何？ 答：目前国内的IGBT市场规模在200亿人民币左右，大约占全球市场规模的40%，目前主要是国外厂商主导。进

	口替代方面，国内的企业会在应用方面选择由低往高突破，由消费类产品往工控和汽车电子拓展。 问题四：公司 IGBT 产品目前进展如何，2020 年目标？主要应用是什么？ 答：公司 IGBT 产品去年实现销售收入约 6000 万元，销售额同期增长 45%，今年目标是维持去年同期增速。产品形态上，发展单管系列化产品的同时发展模块产品。 公司 IGBT 产品主要应用为逆变焊机、感应加热、UPS、逆变器、变频器、电机驱动、工业电源等。 问题五：公司目前产品的原材料是进口的吗？ 答：目前公司原材料有进口也有国产的，国内一些公司在材料方面已经取得了不错的进展。 问题六：公司今年的产能有多少？ 答：公司目前 6 英寸晶圆产能 247 万片/年，8 英寸晶圆 133 万片/年。今年通过技改，8 英寸晶圆产能略有提升，如 MEMS 产能，但总体产能变化不会很明显。 问题七：公司是否有涉及快充类产品？ 答：公司有一些 MOSFET 产品、AC-DC 产品用于快充领域，氮化镓的产品公司还在研发中。 问题八：公司上市之后募集资金的用途？ 答：公司募集资金用途在招股书中有披露：公司原计划募集资金 30 亿元，其中 50%用于 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目，20%用于前瞻性技术和产品升级研发项目，10%用于产业并购及整合项目，20%用于补充营运资金。公司最后超募加绿鞋机制的行使致使募集资金增加了约 12 亿元，增加的资金将用于对外投资并购。 问题九：美国近日对国内半导体代工厂启动半导体“无限追溯”机制，会不会对公司未来的经营造成一些影响？ 答：美国启动的机制对于目前公司经营没有造成影响。 问题十：公司产品应用及下游客户构成？ 答：公司产品前五大应用分别是低速电动车、手机及附件、家电（黑白电及小家电）、照明及电动工具，其余应用范围有服务器、UPS、消防烟报、工业控制及汽车电子等。 问题十一：国产化浪潮对公司的影响？ 答：在整个半导体产业链中，材料端和设备端是国产链条上较为薄弱的环节。公司业务不涉及这两个环节，但是作
--	--

	为 IDM 公司，公司在积极推进设备、材料国产化进程。 在国产替代的推动下，公司产品迎来新的机遇，国内整机厂商和芯片厂商交流越来越紧密，相信在整机厂商的带动下，国内芯片公司的技术水平可以得到进一步提升。 问题十二：公司对今年整个行业以及对晶圆代工行业的看法，业绩目标是否因疫情有调整？ 答：半导体行业从 2018 年四季度开始进入下行周期，2019 年是行业低谷，按照半导体周期性规律，2020 年应是缓慢复苏期，因疫情影响，2020 年可能还是低谷。但公司仍然维持既定的业绩目标，没有因为疫情下调预期，今年公司晶圆代工的业绩能否达到预期主要取决于下半年的业绩表现。 问题十三：公司晶圆制造业务和同业公司相比毛利率情况如何？ 答：部分同业公司毛利率比公司高，主要原因是成本结构的差异，部分同业公司除了新建的生产线，其他生产线基本上完成了折旧，所以毛利率有优势。剔除折旧的原因，公司与同业公司在晶圆制造方面的毛利率差距不大。 问题十四：公司的境外业务今年会受影响吗？ 答：公司的境外业务主要来自制造与服务板块，目前来看，国外公司的订单并没有减少，因为东南亚一些海外公司的制造基地（如封测业务），由于疫情的影响，很多当地企业不能开工，一些海外订单转到了国内。 产品业务方面，公司的客户大部分都是国内客户，截至目前，我们感受到家电（主要是黑白电）类客户受疫情影响比较大。 问题十五：公司有无境外收购的计划？ 答：公司曾经两次尝试出海并购，但因各种因素没有成功。虽然目前国际大环境在不断变化，但公司始终关注潜在的海外标的，也会考虑采取合适有效的方式，例如设立合资公司，合作开发等。 问题十六：公司未来产能投资规划？ 答：公司不盲目追求同等技术水平下的产能扩张，公司未来更加关注技术能力提升方面的资本性开支。 问题十七：公司对于六英寸晶圆，会不会采取降价的方式来换取订单？ 答：公司不会采取降价的方式来换取订单。公司除了给客户代工服务，也拥有自有产品，公司可以通过自有产
--	---

	品的滚动预测，调配六英寸生产线的产能利用率。 问题十八：公司在 12 英寸晶圆片上有哪些布局？对上市公司是否有影响？ 答：2018 年公司与重庆地方政府签订了协议，在重庆公司现有厂房内建一条 12 英寸生产线，该项目按原定计划推进中，正在履行相关审批程序，计划 2020 年启动该项目。 问题十九：公司制造业务中有多少收入是来自封装领域？封测业务收入有提升空间吗？ 答：2019 年公司封装测试业务约为 8 亿元，预计今年该业务收入会有所增加，一方面来自于投资并购项目；另一方面，公司面板级封装项目今年有望实现销售。 问题二十：公司封装代工和晶圆代工的客户群有何差异？ 答：公司封装业务的海外客户占比较高，晶圆代工主要是国内的设计公司。 问题二十一：从长期来看，公司晶圆代工业务的毛利润有改善空间吗？ 答：公司 2 条 8 英寸生产线均于 2011 年规模生产，公司规定的折旧年限是 8 年，目前看每年有一亿多折旧减少，会持续到 2022 年左右。随着公司折旧进一步下降，晶圆代工业务的成本结构得以改善，如果晶圆代工的产能利用率可以持续饱满，该业务未来几年的毛利率会有一定幅度提升。 问题二十二：公司目前的 IGBT 产品处于第几代？ 答：对于 IGBT 代际的定义，目前国际上并没有设立统一标准。 参考英飞凌的标准，公司目前量产的 IGBT 产品技术类似于英飞凌 IGBT 第四代产品，公司第五代 IGBT 产品技术在研发中，预期今年会有成果，并在此基础上陆续开发不同应用频率的产品。 问题二十三：公司对于碳化硅业务的展望？ 答：公司在碳化硅领域布局较早，通过与国内知名高校合作研发，从碳化硅的产品设计到制造进行了全产业链的布局。在材料端有计划通过参股的方式进行布局。 公司的碳化硅二极管产品今年预计实现销售额，公司碳化硅产品的目标应用领域是太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。公司碳化硅的 MOSFET 产品研发取得了一定进展。 问题二十四：公司一季度毛利率同比提高的原因？
--	--

	答：公司一季度毛利率较去年同期有提高，首先因为2020年春节，公司主要产线正常运营，产能利用率有所提升。其次，公司近年来不断加大成品化比重，产品与方案的营收比重提高，且毛利率高于制造业务。 问题二十五：公司今年的业绩目标？ 答：根据在股东大会通过的《2020年度财务预算报告》议案，公司2020年度预计实现营业收入653,336万元。 问题二十六：在公司产品与方案板块中，各类型产品的收入分布？ 答：在产品与方案板块中，MOSFET产品占比约62%，功率IC产品占比约14%，传感器产品占比约6%，IGBT产品及智能控制产品占比约7%。 问题二十七：公司外延的方向有哪些？ 答：公司未来外延的方向主要有两个方向：产品方面，重点关注功率半导体和智能传感器相关的企业；制造方面，重点关注可以快速提高公司制造技术能力的企业。 问题二十八：硅片国产化现状，未来三年国产化进度展望？ 目前公司大部分六英寸硅片可以实现国产化。8英寸硅片的国产化率不高。公司一直在努力推动材料端的国产化进程，和国内供应商一直保持积极合作。 问题二十九：公司的产品方案，和代工客户之间会不会有竞争？ 答：公司代工业务与自有产品业务之间有比较严密的防火墙设置。首先公司会与专有技术的客户签署相关的专有技术保护合同，同时所有的外部客户技术都是在代工的文控系统中单独加密管理，公司代工信息安全管理也获得了信息安全管理体系认证，目前已经有12年的管理经验，这是我们做到信息安全事件零发生、保护好客户知识产权的法宝之一。 同时公司实施IDM模式的战略已经有较长时间，华润微电子代工客户已对公司有充分的了解和信任。
日期	2020年5月